# 株式会社 トリケミカル研究所 第46期(2024年1月期) 第2四半期決算説明資料

東京証券取引所 証券コード: 4369



1. 2024年1月期第2四半期決算実績



|       | 24.1期 | - 14.15A - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | (ご参考)<br>23.1期<br>上期実績 | (ご参考)前 | <b>万年同期比</b> |
|-------|-------|--|------------------------|--------|--------------|
|       | 上期実績  | 上期計画   |                        | 増減額    | 増減率          |
| 売上高   | 5,622 | 7,100  | 6,548                  | -926   | -14.1%       |
| 営業利益  | 1,100 | 1,620  | 1,911                  | -810   | -42.4%       |
| 経常利益  | 1,906 | 2,410  | 3,508                  | -1,601 | -45.7%       |
| 当期純利益 | 1,453 | 1,870  | 2,703                  | -1,250 | -46.2%       |

メモリー半導体向けを中心に顧客の稼働減を受けて大幅な落ち込み 売上・利益ともに前年比大幅減・計画未達 経常利益に持分法投資利益649百万円(前年同期比-44.8%) 現況を鑑み通期計画を下方修正



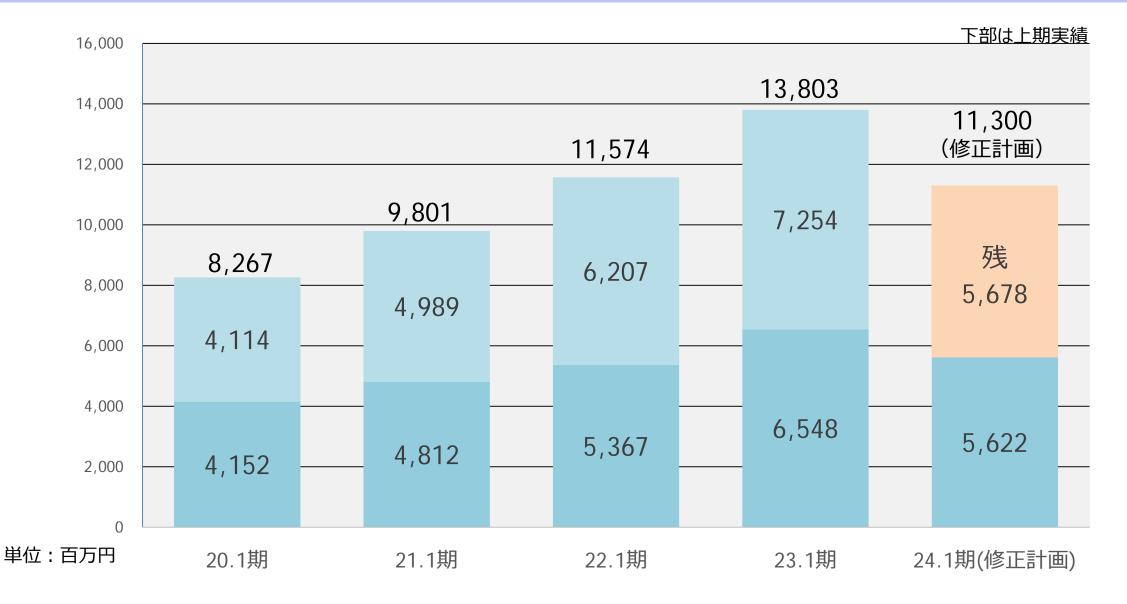
|            | 23/7月末 | (ご参考)<br>23.1期末 | 増減額    |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 流動資産       | 19,624 | 18,922          | 701    |
| 固定資産       | 12,162 | 13,192          | -1,030 |
| 資産合計       | 31,787 | 32,115          | -328   |
| 流動負債       | 3,207  | 3,675           | -467   |
| 固定負債       | 2,113  | 2,563           | -450   |
| 負債合計       | 5,320  | 6,239           | -918   |
| 株主資本       | 25,744 | 25,265          | 478    |
| その他包括利益累計額 | 722    | 610             | 111    |
| 純資産合計      | 26,466 | 25,876          | 590    |
| 負債純資産合計    | 31,787 | 32,115          | -328   |

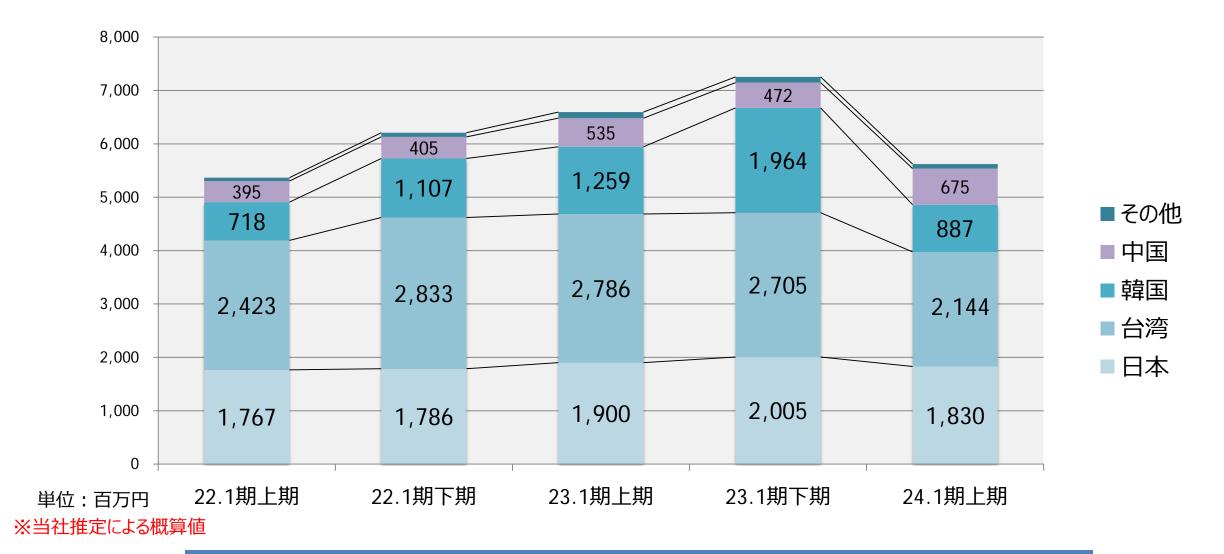
| 主な増減 | 要因                          |                |
|------|-----------------------------|----------------|
| \    |                             |                |
| 流動資産 | 現金及び預金の増加棚卸資産の増加            | +1,107<br>+948 |
|      | 売上債権の減少                     | -1,199         |
| 固定資産 | 持分法適用会社からの配当に伴う<br>投資有価証券減少 | -1,812         |
|      | 有形固定資産の増加                   | +629           |
|      |                             |                |
| 流動負債 | 未払法人税等の減少買掛金の減少             | -263<br>-248   |
| 固定負債 | 長期借入金の減少                    | -363           |
| 純資産  | 純利益計上による利益剰余金の増加            | +478           |

|                  | 24.1期上期 | (ご参考)<br>23.1期上期 |
|------------------|---------|------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,649   | 4,496            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104  | -1,037           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435  | -1,179           |
| 現金及び現金同等物の増減額    | 1,107   | 2,272            |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 12,245  | 10,306           |

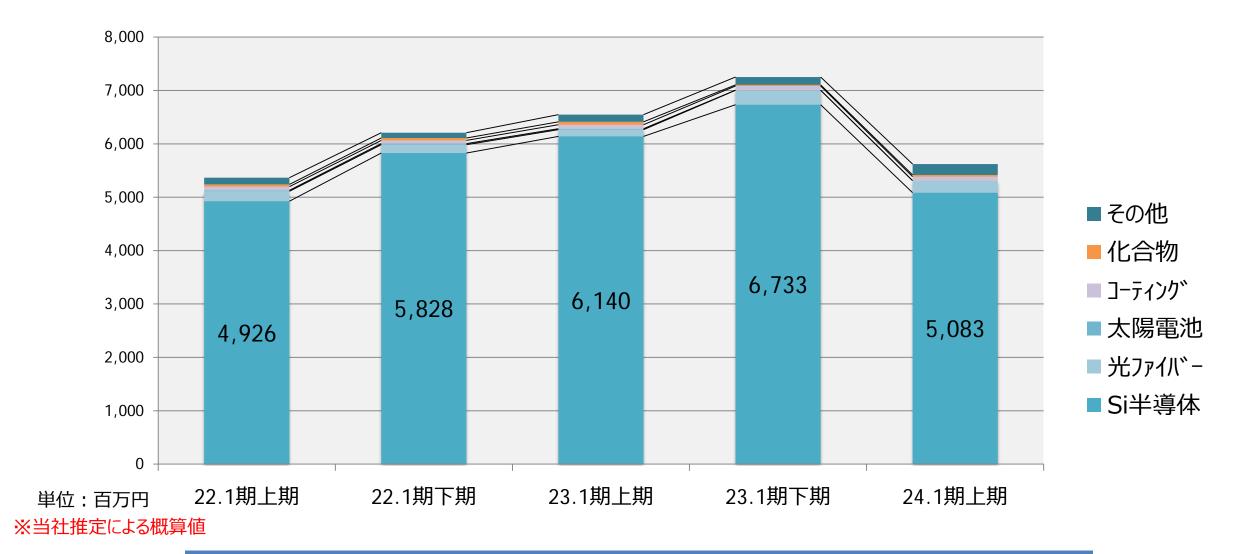
#### CFの状況

| 営業CF | 税前当期利益計上<br>利息・配当金の受取額<br>売上債権の減少額<br>棚卸資産の増加額<br>法人税等の支払額 | +1,906<br>+2,542<br>+1,208<br>-938<br>-863 |
|------|--|--|
| 投資CF | 有形固定資産の取得  | -1,086                                     |
| 財務CF | 借入金の返済額<br>配当金の支払額   | -413<br>-973                               |



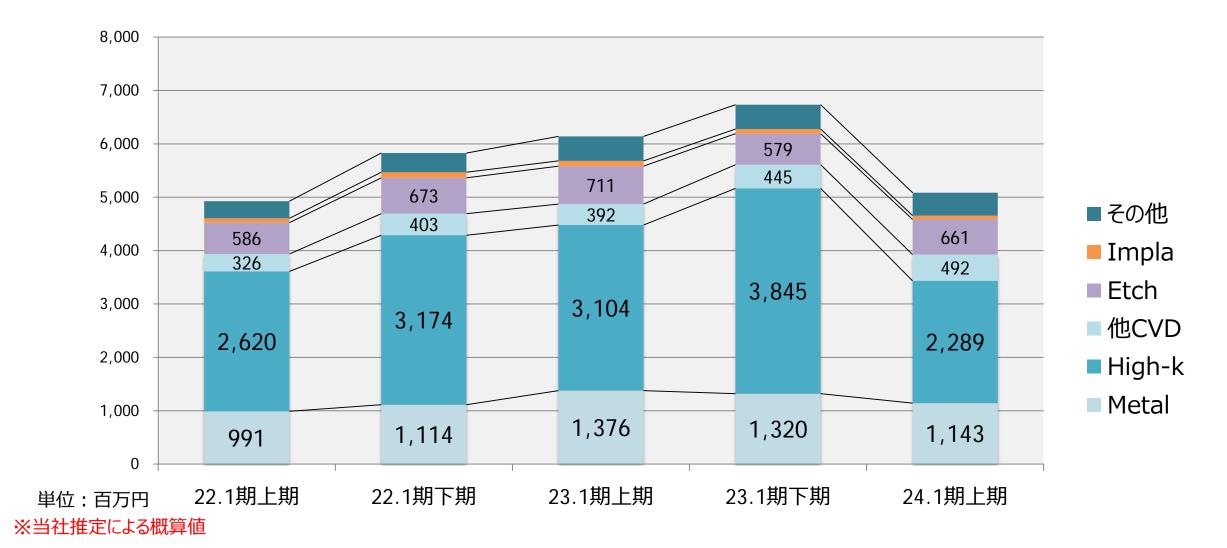


台湾・韓国向けを中心に大幅減



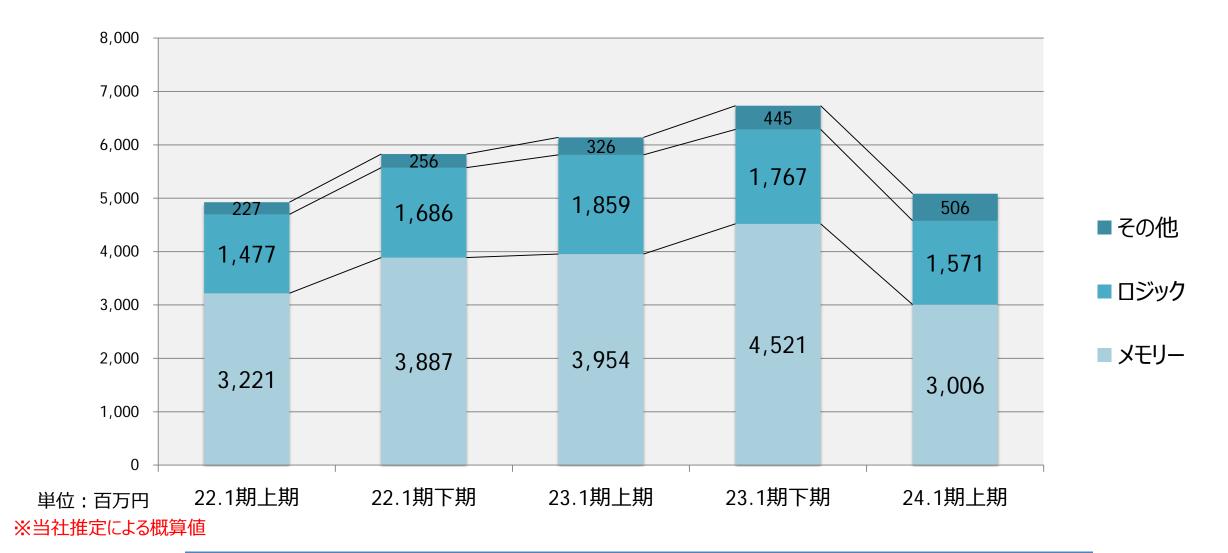
半導体向け売上の減少



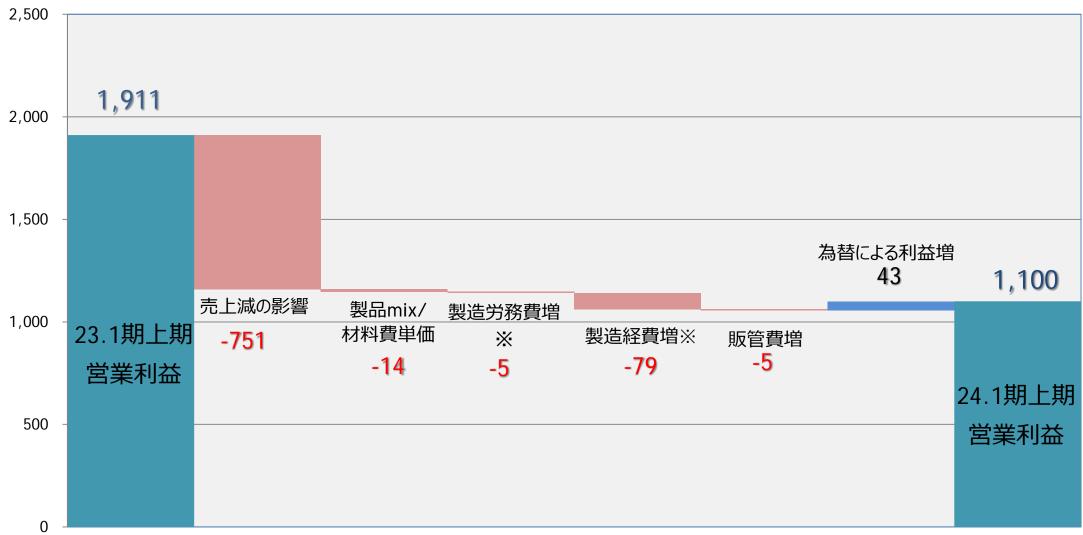


## High-k向け材料の大幅落ち込み





メモリーの減産・在庫調整の影響大



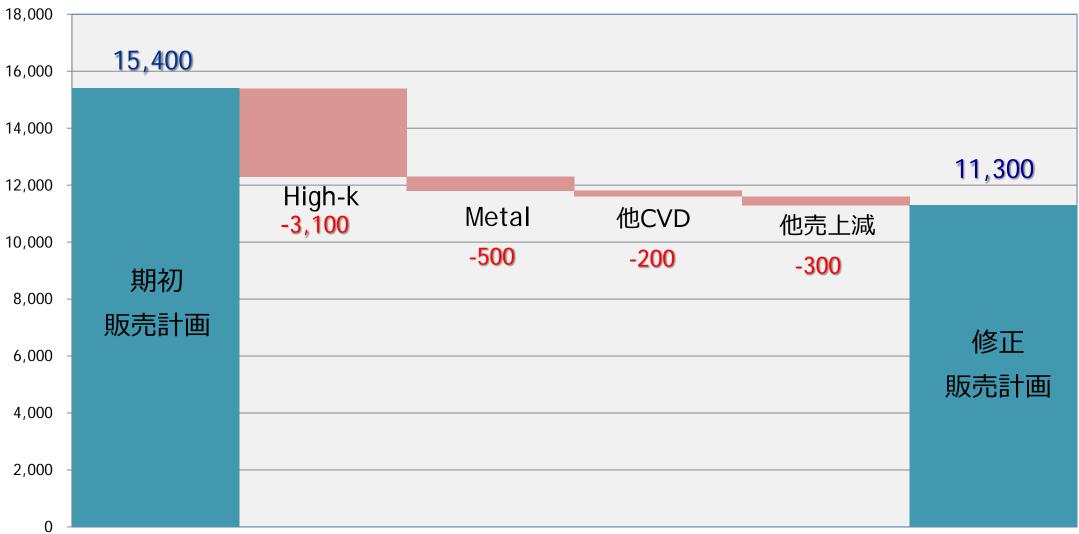
2. 2024年1月期業績見通し及び戦略

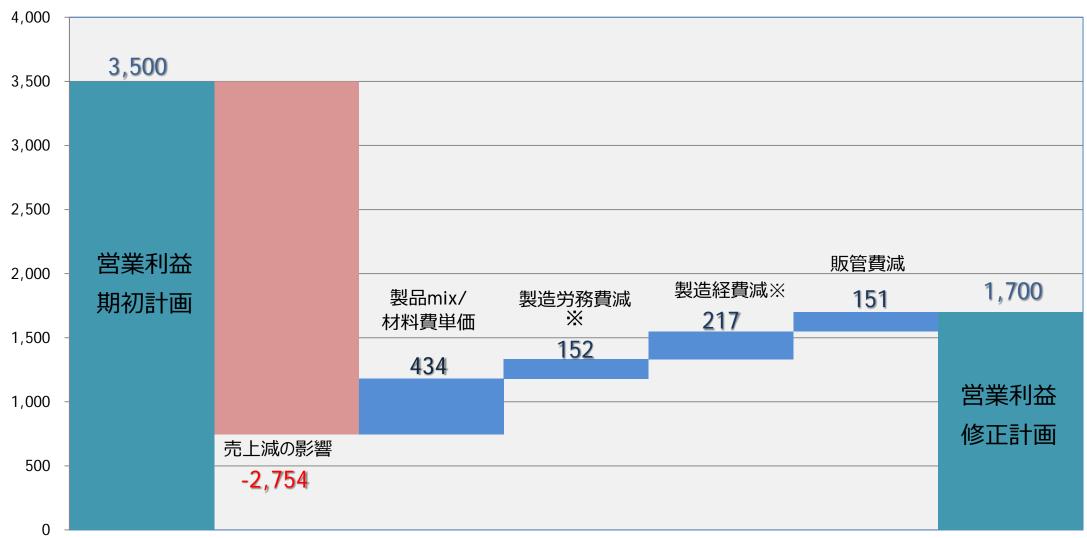


|       | 24.1期 <b>上</b> 期 | 24.1期通期<br>(8/31修 <b>正計</b> 画) | 進捗率<br>(対修正計画) | (ご参考)<br>修正前<br>24.1期通期計画 | (ご参考)<br>23.1 <mark>期通期</mark> |
|-------|------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 売上高   | 5,622            | 11,300                         | 49.8%          | 15,400                    | 13,803                         |
| 営業利益  | 1,100            | 1,700                          | 64.8%          | 3,500                     | 3,504                          |
| 経常利益  | 1,906            | 3,370                          | 56.6%          | 5,450                     | 6,186                          |
| 当期純利益 | 1,453            | 2,680                          | 54.2%          | 4,250                     | 4,832                          |

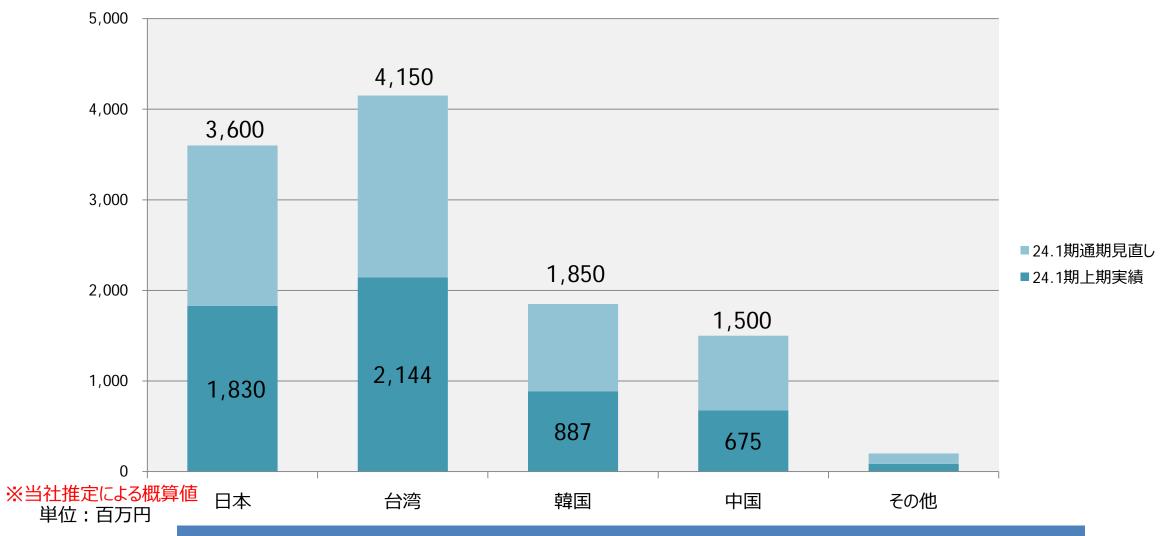
現況を鑑み通期業績予想を下方修正 売上は2Q、利益は3Qを底と見込む 持分法投資利益 期初計画20億→15億に修正



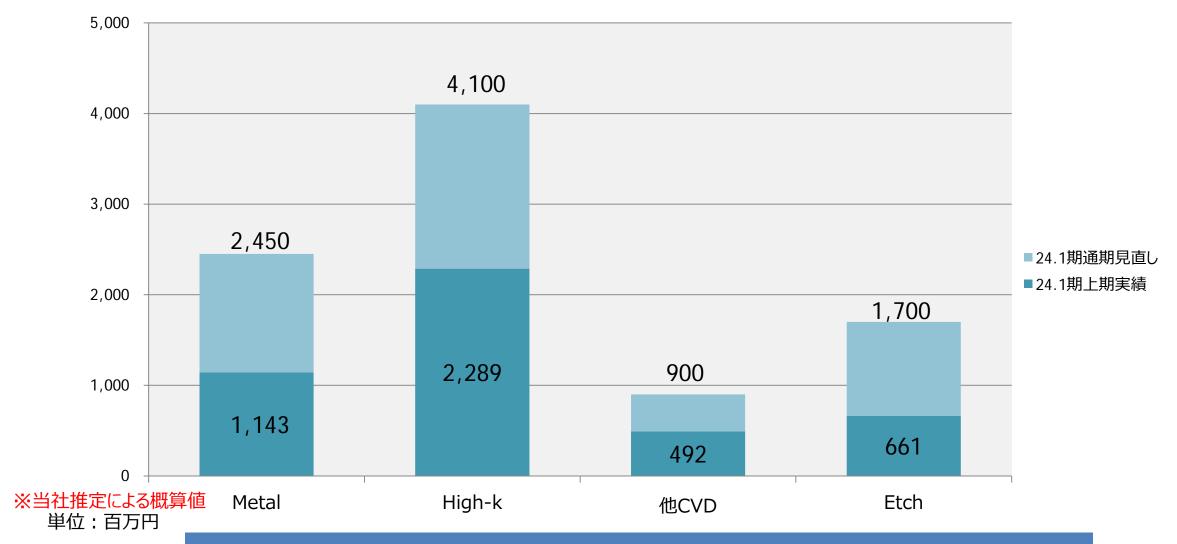




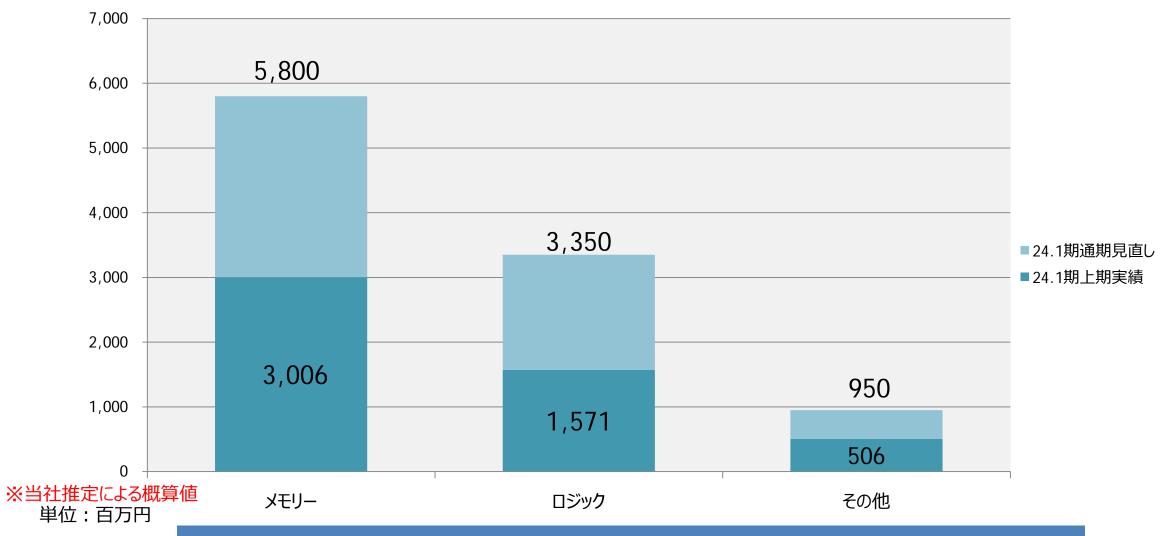
単位:百万円 ※研究開発費振替前



中国向けの成長と韓国向けの回復



High-kは今期低迷・Etching材料の成長に期待



今期メモリ向けは低迷



## 外部環境見通しなど

- 1. ロジックは徐々に回復、メモリはDRAMを中心に当面低水準
- 2. 中国向け売上は比較的堅調
- 3. 一部原材料は高騰も販売価格の交渉は継続

### 下期の施策

- 1. 次世代半導体材料の生産体制整備
- 2. 第2工場を中心とした既存材料の生産性向上
- 3. 安全・品質管理体制の強化継続
- 4. 台湾子会社工場2期工事・顧客による製品評価継続

3. 中期経営計画各施策の進捗





名称:南アルプス事業所

建設予定地:

山梨県 南アルプス市 下今諏訪A工業団地

敷地面積:約30,000m2

竣工:2024年末

稼働開始予定:2025年

次世代材料候補

次世代3D NAND用新規エッチング材料

- ・短時間で深掘り(400層を超える積層構造に対応)が可能
- ・本製品はカーボンを含有しないためプロセスの環境負荷を低減 顧客による評価は良好・当初の想定を上回る市場拡大の可能性も

先端ロジック向けCVD材料

5nm以降の最先端ロジック半導体において市場投入開始 低誘電率(Low-k)絶縁膜材料

ロジック向けHigh-k材料

顧客の使用条件に合わせ付加価値を向上

他メモリ向け新規Metal材料・既存製品性能向上のための新材料等







# 今期中の竣工を予定

2023統合報告書



https://www.trichemical.com/ir/pdf/report\_2023.pdf



この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた 当社の経営判断に基づいております。 あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際

くださいますようお願い申し上げます。

の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめご承知おき

お問合せ先: homepageinfo2@trichemical.com